

投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2026-003〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	光大证券、盈泉投资、财联社
时间	2026-4-1
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节</p> <p>Q: 请问碳化硅市场近期是否有复苏迹象？</p> <p>A: 根据了解到的市场情况，碳化硅衬底市场于近月释放出了积极信号。碳化硅衬底价格呈现结构性上涨，6英寸产品价格较大幅度反弹，8英寸价格则止跌企稳并小幅上涨。部分衬底厂商已收到其下游客户的新增订单需求。行业供需格局得到明显改善。</p> <p>Q: 请问碳化硅行业未来增长点来源于哪里？</p> <p>A: 长期来看，碳化硅行业具备明确且广阔的市场空间，在现有应用场景持续渗透的同时，下游新兴应用不断涌现，已成为了碳化硅行业未来重要的增长驱动力。在人工智能快速发展的带动下，数据中心，高端算力芯片，智能驾驶等领域持续迭代升级。碳化硅凭借其优异的材料特性，在这些领域关键环节中发挥重要作用，有望推动行业需求实现高速增长。</p> <p>Q: 公司目前硅业务板块的市场份额相对偏低，未来几年是否有提升规划？</p> <p>A: 在半导体硅领域，国内企业起步较晚，与国际先进水平仍存在差距，且海外厂商凭借前期在头部客户的长期验证积累，具备了一定的先发优势。因此，目前半导体硅相关设备的整体国</p>

产化率较低，由国外进口设备占据主要市场份额。一直以来公司在半导体硅方面不断自主研发，目前正积极加强内部实验与测试，重点瞄准更高规格、更高性能要求的方向推进技术攻关和迭代，稳步缩小与海外的差距，持续提升相关业务的竞争力与市场份额。

Q: 请问并购项目目前进展及标的公司业绩承诺情况？

A: 公司已向上海证券交易所递交申请文件并已收到受理通知，截止目前处于问询阶段。业绩承诺期间承诺净利润数可参照公司已披露的并购重组相关文件。